

JASA News 2025年度 **021号**をお届けいたします。

このメールはJASA会員の**代表者様・副代表者様・連絡ご担当者様**、ご指定いただいた「教育」・「人事」・「総務」・「技術」各分野のご担当者様、ならびに受信ご希望者に送信しています。

»» 各記事について、**ご関係者様への転送**をお願いいたします。««

■ □ ————— □ ■

1. RISC-V 第22回Webセミナー
2. 半導体系オンラインセミナーご招待
3. 会員イベント情報「日本システム開発」

■ □ ————— □ ■

1. RISC-V 第22回Webセミナー

(技術本部 ハードウェア委員会 RISC-V WG)

RISC-Vワーキンググループ(技術本部 ハードウェア委員会)が主催するWebセミナーです。

(一社) OpenSUSI代表理事である岡村氏から世界の取り組み状況をご紹介します。

これから日本はどう取り組んでいくべきかを考えていく上で、とても参考になる内容です。技術者の方はもちろん、会社や組織の幹部の方にも是非聴いていただきたいセミナーです。

講演テーマ：

オープン・ソース・EDA関連ー FSIC 2025とセキュリティ・キャンプ紹介 ー

開催日時 **9月24日(水)15:00~16:00**

開催形態 Webセミナー

* Microsoft Teamsによる配信。参加お申込者には後日参加URLをご案内いたします。

参加申込 参加費：無料

詳細・申込み：https://www.jasa.or.jp/lists/risc-v-22web_seminar/

2. 半導体系オンラインセミナーご招待

(SEMI 国際半導体製造装置材料協会)

国際半導体製造装置材料協会様より、JASA会員向けにWebセミナーのご招待です。

オンラインセミナー

伝説のシステムアーキテクトが語る未来 & アナリストが見る半導体材料市場展望

AI時代の到来により、計算インフラと半導体材料の進化はかつてないスピードで加速しています。本セミナーでは、世界的に著名なシステムアーキテクトが、未来のコンピューティングを支える「オープンハードウェア」の可能性について語るとともに、次世代設計人材の育成に向けた取り組みも紹介します。

また、材料分野に精通したアナリストが、技術ロードマップと材料革新の最新動向を詳細に解説。次世代コンピューティングの設計思想を紹介するとともに、半導体材料の技術革新や市場動向を包括的に取り上げることで、業界の未来を見通すための実践的かつ戦略的な知見を提供します。

※内容はやむを得ず変更となる場合がございます。予めご了承ください。

開催日時 **9月25日(木) 10:30~11:50**

無料視聴のお申込み

<https://www.jasa.or.jp/dl/gov/20250912.pdf>

3. 会員イベント情報「日本システム開発」

(ビジネス交流委員会)

Web無料セミナー

『AI技術を活用した組込みシステムのトレーサビリティ効率化』

組込みソフトウェア開発において、「システム開発仕様書」と「ソースコード」の確認作業は重要な一方で、リソースの確保等大きな負担となっているかと存じます。本Webinarでは、弊社独自AI技術を用いて、これらの作業を飛躍的に効率化するソリューションをご紹介します。

本年11月に同ソリューションβ版のリリースを予定しております。本セミナーではその最新情報と、広く皆様にご利用いただくためのプログラムについてご説明いたします。

併せまして、開発下流工程での静的解析ツール指摘修正、テスト領域についての取り組みについてもご説明申し上げたいと考えます。

日時：**10月9日(木) 16:00~17:00**

背景

中小企業庁Go-Tech事業に2023年より採択され、島根大学と共同で開発を進めてきたAI技術の活用仕様書とソースコードの紐付けや確認作業を自動化し、開発工数を大幅に削減

詳細・申込み

https://www.nskint.co.jp/pr_news/seminar/ai_seminar_20251009/

〃〃〃〃 発信元 〃〃〃〃

一般社団法人 組込みシステム技術協会

本部事務局 jasainfo@jasa.or.jp

✓ [御社のイベント・製品情報](#)をJASAから業界配信いたします。

✓ [採用・教育・総務・技術](#) ご担当者を「送信先に追加登録」してください。

✓ [会員向け専用サイト](#) 会員限定サービス・会員情報配信・会員情報変更